

低溫微波加熱系統注意事項

- 1.目前僅開放Si、Ge、III-V族基板，特殊基板請找機台負責人討論。
- 2.若為整片的金屬模，厚度不可超過30nm，且微波Power設定需低於300%。
- 3.目前不開放含Au、Ag、Cu、Fe的材料。
- 4.本機台有5顆Power做為加熱源，1顆Power全開代表100%，5顆Power全開代表500%。
- 5.一般Si基板離子佈值活化建議使用400% 300s以下即可。